

D145信息披露

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2025-019

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等),拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
● 投资金额:使用最高不超过人民币6.50亿元的闲置募集资金及不超过人民币8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

● 履行的审议程序:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见。

● 特别风险提示:本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场发生宏观经济波动时,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地买入、不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致投资效益未达预期的风险。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2023]1521号)文,公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股发行价格为人民币75元,募集资金总额为人民币150,075万元,扣除相关发行费用人民币12,426.7万元后,实际募集资金净额为人民币137,648.31万元,上述募集资金已全部到账。收取时间:2023年3月27日。公司对本次公开发行股票所募集的资金按照以下程序进行了审计,并出具了《美芯晟科技(北京)股份有限公司募集资金验资报告》(皖信会审[2023]第1000000231号)。

募集资金到账后,公司按照相关规定及时设立了专户存储管理,并和公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况
根据《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	LED智能照明系统研发及产业化项目	14,497.18	14,497.18
2	无线充电技术研发及产业化项目	30,389.28	30,389.28
3	有线快充技术研发项目	15,063.70	15,063.70
4	信号链芯片研发项目	20,109.91	20,109.91
5	补充流动资金	19,939.93	19,939.93
	合计	100,000.00	100,000.00

(二)募集资金使用情况
截至2024年12月31日,公司募集资金累计投入82,036.57万元,募集资金余额为71,289.21万元,其中募集资金用于现金管理余额为52,200.00万元,募集资金账户具体明细如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	150,075.00
减:已支付计入募集资金总额	82,036.57
其中:上期计入募集资金总额	12,392.37
本期投入募集资金用于支付发行费用(不含税金额)	34.42
截止本报告期末累计投入募集资金总额	57,628.68
其中:上期投入募集资金总额	39,019.71
本期投入募集资金总额	18,608.97
超募资金用于支付发行费用	11,981.20
其中:上期用于支付发行费用	4.81
本期用于支付发行费用	11,981.20
本年使用募集资金	586.71
其中:上期用于募集资金利息收入	350.91
本年使用募集资金	235.81
其中:上期用于募集资金利息收入	2,667.68
本年使用募集资金	1,185.05
其中:上期用于募集资金利息收入	1,462.63
减:手续费支出	3.61
其中:上期用于支付手续费支出	0.20
本年用于支付手续费支出	3.41
减:募集资金用于永久补充流动资金	
其中:上期用于募集资金用于现金管理投资	52,200.00
报告期内用于现金管理投资	52,200.00

注:上表各项加总数与合计数若有差异,系四舍五入造成。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为规范募集资金使用及自有资金的使用效率和收益,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下,公司将使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加公司投资收益,保障公司股东的利益。

(二)投资期限及期限
1、募集资金
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

2、自有资金
公司拟使用最高不超过人民币8.00亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种
1、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等),且该等使用募集资金不得用于质押、不得用于补充流动资金为目的的投资行为。

2、自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

(四)决议权限
自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式及信息披露
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不得变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配
1、募集资金
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补充募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管规定的要求管理使用募集资金。

2、自有资金
公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,将用于补充公司流动资金及其他生产经营支出。

四、对公司经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会对公司正常生产经营所需资金和募投项目的正常运转、不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时,对部分闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步补充公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险提示及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场发生宏观经济波动时,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地买入、不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致投资效益未达预期的风险。

(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理投资产品的购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资产品,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务及相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露的义务。

六、履行的审议程序及专项说明
(一)审议程序
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币6.50亿元的闲置募集资金及不超过人民币8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见
监事会认为,保证不影响募集资金投资项目正常实施,不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用最高不超过人民币8.00亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《募集资金管理制度》,内容真实、程序合法,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构核查意见
保荐机构根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金监管协议。公司本次使用的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,无需提交公司股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目进展,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司全体股东的利益。

综上所述,保荐人对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件
1、(中信建投证券股份有限公司)关于美芯晟科技(北京)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2025年4月30日

美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司2024年第二届董事会第三次会议及2024年第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 不被及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第12.9.1条第一款第(八)项》规定的不得实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》的规定,不满足现金分红条件,故公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司现金分为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关指标计算。”公司本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,811,978.94元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计119,811,978.94元,占本年度归属于上市公司股东的净利润(绝对值)的比例为180%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销的金额合计119,811,978.94元,占本年度归属于上市公司股东的净利润(绝对值)的比例为0%。

本次利润分配和方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求,为了更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已有的股利回报规划,董事会会议将决议提交2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2025年4月29日召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司的实际情况,不会对公司经营业绩产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟

美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示
公司在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

三、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。
五、会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司本报告期内部控制评价报告结论为有效。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》的规定,不满足现金分红条件,故公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》的规定,不满足现金分红条件,故公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司现金分为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关指标计算。”公司本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,811,978.94元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计119,811,978.94元,占本年度归属于上市公司股东的净利润(绝对值)的比例为180%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销的金额合计119,811,978.94元,占本年度归属于上市公司股东的净利润(绝对值)的比例为0%。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司简介
一、公司简介
1.1 公司概况
√适用 □不适用

1.2 公司主要业务
√适用 □不适用

1.3 联系人及联系方式
√适用 □不适用

1.4 公司网站
√适用 □不适用

1.5 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.6 公司注册地址
√适用 □不适用

1.7 公司办公地址
√适用 □不适用

1.8 公司电话号码
√适用 □不适用

1.9 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.10 公司网站
√适用 □不适用

1.11 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.12 公司网站
√适用 □不适用

1.13 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.14 公司网站
√适用 □不适用

1.15 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.16 公司网站
√适用 □不适用

1.17 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.18 公司网站
√适用 □不适用

1.19 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.20 公司网站
√适用 □不适用

1.21 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.22 公司网站
√适用 □不适用

1.23 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.24 公司网站
√适用 □不适用

1.25 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.26 公司网站
√适用 □不适用

1.27 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.28 公司网站
√适用 □不适用

1.29 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.30 公司网站
√适用 □不适用

1.31 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.32 公司网站
√适用 □不适用

1.33 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.34 公司网站
√适用 □不适用

1.35 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.36 公司网站
√适用 □不适用

1.37 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.38 公司网站
√适用 □不适用

1.39 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.40 公司网站
√适用 □不适用

1.41 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.42 公司网站
√适用 □不适用

1.43 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.44 公司网站
√适用 □不适用

1.45 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.46 公司网站
√适用 □不适用

1.47 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.48 公司网站
√适用 □不适用

1.49 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.50 公司网站
√适用 □不适用

1.51 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.52 公司网站
√适用 □不适用

1.53 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.54 公司网站
√适用 □不适用

1.55 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.56 公司网站
√适用 □不适用

1.57 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.58 公司网站
√适用 □不适用

1.59 公司电子邮箱
√适用 □不适用

1.60 公司网站
√适用 □不适用

System)等,对良率进行实时监控与超频管理。

客户质量建设:公司建立了“三位一体”客户服务体系,为客户提供完整、快速、专业、便捷的产品质量服务。公司已通过了ISO9001认证,并开始逐步建立汽车电子领域的AEC-Q100认证体系。

2.3 所处行业情况
(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要驱动因素
① 行业现状
公司主要从事高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售,根据《2017年国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2019)》,公司所属行业为“集成电路设计”。

(2) 所属产业链情况
集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游为芯片制造,产业链下游为芯片封装测试。

集成电路产业链上游为芯片设计,中游为芯片制造,下游为芯片封装测试。产业链中游